

9-2057470-0 ✓ 有效

STRADA

TE 内部编号 9-2057470-0

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 199 Position, 2.5 mm

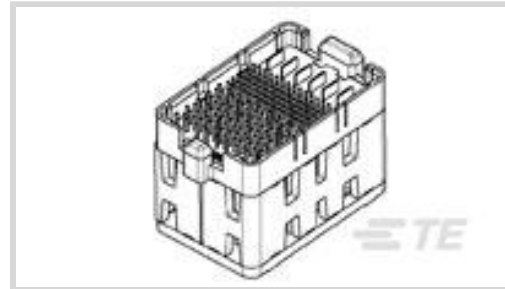
/ 1.5 mm / 3.1 mm [.24 in / .06 in / .12 in] Centerline, Fully

Shrouded, Gold Flash

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 199

中心线 (间距) : 1.5 mm, 2.5 mm, 3.1 mm, 6.2 mm [.06 in, .1 in, .12 in, .24 in]

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 免焊连接

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

每列的对数	8
电源位置数量	6
线对数量	32
板对板配置	平行
装载位置数量	193
可堆叠	是
信号位置数量	8
位数	199
PCB 安装方向	垂直

电气特征

介质耐压 (最大值)	750 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ



阻抗	100 Ω
----	-------

工作电压	250 VAC
------	---------

信号特征

数据速率	16 Gb/s
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	交错
------	----

对接公端宽度	.69 mm, 4.5 mm [.027 in][.177 in]
--------	-----------------------------------

对接公端厚度	.3 mm, .41 mm [.011 in][.015 in]
--------	----------------------------------

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm [30 μin]
--------------	-----------------

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	圆形, 圆形
---------	--------

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	铜合金
------	-----

端子接触部电镀材料	镀金
-----------	----

端子类型	插针
------	----

端子额定电流 (最大值)	1.5 A
--------------	-------

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.15 mm, .3 mm [.005 in][.011 in]
-------------	----------------------------------

矩形端接柱体和尾部宽度	.43 mm, .73 mm [.016 in][.029 in]
-------------	-----------------------------------

端接柱体和尾部长度的	1.45 mm, 2.05 mm [.057 in][.08 in]
------------	------------------------------------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

接合固定	带有
------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体特性

外壳材料	LCP (高温热塑塑料)
------	--------------

中心线 (间距)	1.5 mm, 2.5 mm, 3.1 mm, 6.2 mm [.06 in][.1
----------	--

in][.12 in][.24 in]

尺寸

堆叠高度	40 mm[1.575 in]
连接器高度	39.8 mm[1.564 in]
PCB 厚度 (建议)	.06 mm[.8 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	24
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-2057470-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-2057470-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-2057470-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)